LAGENAUFBAU HDI (Standard)

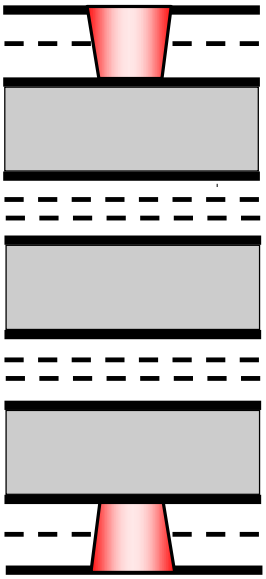
HDI08_1+6+1_0,90_35

8 - Lagen

Kerne: 0,10 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**1 + 6 + 1**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
	TOP/VS		Folie	12 µm		12	
					1 x 1080	**60**	
	2			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
	3			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
	4			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
	5			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
	6			35 µm		**33**	
			0,100 mm			**100**	
	7			35 µm		**33**	
					1 x 1080	**60**	
	BOT/RS		Folie	12 µm		**12**	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 µm

MATERIALDICKE:	**0,90**	+/-	0,07	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	0,98	+/-	0,10	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,04	+/-	0,12	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Gesamtdicke Material: 890

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
25.04.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	Seite:	4+